
2017年度 活動報告

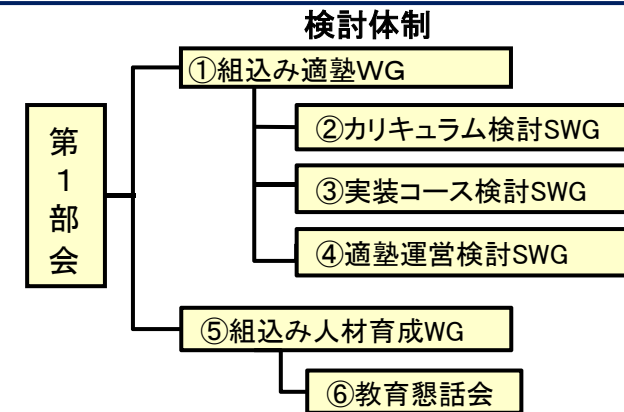


組込みシステム産業振興機構
Embedded System Industry Promotion Organization ESIP

1.(教育事業:第1部会)活動報告

2017年度 事業計画

1. 「組込み適塾」ブランドの価値向上と運営力強化
 - 第10回組込み適塾の改善・拡充とプロモーション強化(①、②、③)
 - 安定かつ効率的な適塾運営に向けた運営力強化(④)
 - WINKとの連動による相乗的ブランド力向上(①)
2. 自由に議論が出来る”場”の提供
 - 講師/受講生間および修了生を含めた自由で活発な交流の場の提供
 - ITを活用した講師/受講生間の円滑なコミュニケーションの実現(④)
3. 日本の組込みシステム産業発展への貢献
 - 教育懇話会を通じた人材育成施策の検討(⑤、⑥)
 - 企業の人材育成プログラムへの組込み適塾の積極活用支援(①、⑤)
 - 組込み適塾修了生が活躍できる場の拡大(WINKとの連携)(①、⑤)



2017年度の実績

1. 「組込み適塾」ブランドの価値向上と運営力強化

【目標】第10回適塾の安定かつ効率的な運営により、受講者数維持と受講生満足度85%以上。PDCA継続。

【実績】第10回組込み適塾は過去最高の受講者数。運営の安定・効率化の施策が奏功、受講生満足度目標85%を達成。

- ・ 安定かつ効率的な運営のための施策(①学習管理システムMoodleの導入 ②関西会場の集約 ③会場運営業務の外注が奏功、大きなトラブルなく終了。
- ・ 受講者数:203名(前年比140%)、延べ受講者数 698名(前年比110%)。講座アラカルト受講増の一方でコース一括受講も増加し、両極化。
 - 新規参加機関の比率は約1/3で、前年と変わらず。新規・継続とも参加機関数は増加。自動車メーカー、公的機関など従来にない業種から初参加。
 - 遠隔講座は受講者数(20名→38名)、参加機関数(6社→13社)とも大幅に改善。
- ・ 受講生の理解度・業務役立ち度も高水準を維持、新規導入指標の満足度は事業計画目標の85%を達成。
 - 理解度:87.6%(前年:88.2%)、役立ち度:82.1%(前年:82.7%)、満足度:85.7%。
 - 学習管理システムMoodleの導入と運用により、事前理解度(29%→34%)と予習者比率(24.6%→45.4%)ともに大きく良化。
- ・ 講師による評価も良化。但し、遠隔講座は接続が不安定であった問題もあり、一体感・臨場感に課題。遠隔中継の品質・安定性の向上策を検討中。

2. 自由に議論が出来る”場”の提供

【目標】関係者交流会(5回)、講師会、地域交流会、同窓会(各1回)の実施。Moodleの試行・評価。

【実績】受講生・講師・適塾関係者が自由闊達に議論し、組織の壁を越えて交流できる”場”を提供。前年度は開催を見送った講師会・同窓会も開催。

- ・ 交流会(5回)、19講座・のべ44名の適塾関係者による講座参観、前年度見送った講師会(2回:計17名)と10周年を記念した同窓会(60名)を開催。
- ・ Moodleで講師・受講生の質疑応答・交流用掲示板を提供するも、周知が不十分のためほとんど活用されず。今後、講師・受講生への周知を徹底する。

3. 日本の組込みシステム産業発展への貢献

【目標】教育懇話会(3回)の実施と次世代人材育成テーマの創出。出前講座のスキーム確立。

【実績】「デジタル大変革時代の人材育成」をテーマとした教育懇話会を4回開催。出前講座のスキームを検討し、今後、遠隔中継型から試行。

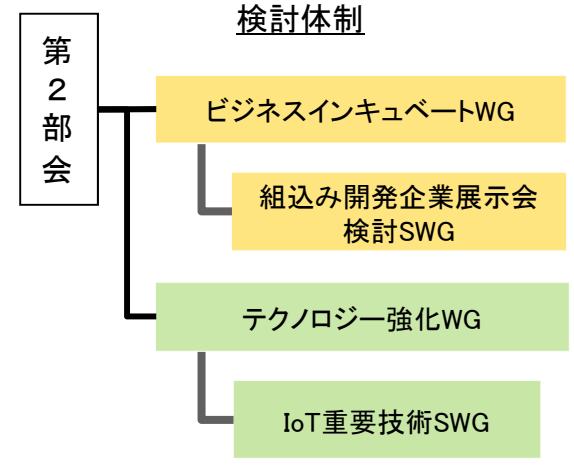
- ・ 教育懇話会を通じた人材育成施策の検討:「デジタル大変革時代の人材育成」をテーマに4回開催(うち3回は講師を招聘して講演を聴講)。
- ・ 企業の人材育成プログラムへの組込み適塾の積極活用支援:利用実態調査を実施。「出前講座」のスキームを検討、遠隔中継型から試行予定。
- ・ 適塾修了生の活躍の場の拡大:WINK2017に今年度と第7回の修了生各1チームが参加、第7回修了生チームがアイデア賞を受賞。

2.(ビジネス支援・競争力強化支援事業：第2部会)活動報告



2017年度 事業計画

1. 展示会開催によるビジネス支援と戦略的出展によるマッチング精度向上
 - －戦略的な出展先(業種、企業、部署)選定と、出展先企業のニーズ情報を事前提供し、展示商品、技術へ反映することでマッチング精度を向上。
 - －組込み開発企業展示会の効果の定量化による客観的評価と出展先企業への継続的な情報提供方法の確立。
 - －組込み開発企業展示会準備作業の効率化による出展企業の負担軽減。
 - －出展先企業への依頼プロセスの確立。
2. IoT重要技術の調査およびプライベートセミナーによる技術競争力強化支援
 - －IoT重要技術の定点調査、およびトピックス調査による技術競争力強化支援。
 - －技術調査に裏付けされたプライベートセミナーを企画・開催し技術競争力強化支援。
 - －ワークショップ開催による会員交流・会員連携につながる場の提供。
3. WINK2017と連携しオープンイノベーション創出の場を提供
 - －プライベートセミナーでのテーマ展示、ワークショップでのアイデアのブラッシュアップの場を提供。
 - －組込み開発企業展示会テーマとマッチした商品・サービス商品は、出展を提案しビジネス支援。



2017年度 実績

(実績①)展示会開催によるビジネス支援と戦略的出展によるマッチング精度向上

- ・組込み開発企業展示会検討SWGでの出展先企業のリストアップと当該企業の調査による戦略的な出展先の選定。
- ・展示会に先駆けての出展先企業のニーズ説明会・製品見学会の実施によるマッチング精度の向上。
- ・組込み開発企業展示会の後日アポ率による定量的評価。(島津製作所での展示会の後日アポ率 約12%)
- ・過去の展示会の出展先への継続的な情報提供方法の確立。
- ・リーフレット作成の外注化による出展企業の負担軽減。
- ・展示会の出展企業メリットを訴求する資料による依頼プロセスの確立。

(実績②)IoT重要技術の調査およびプライベートセミナーによる技術競争力強化支援

- ・国の政策の調査と未来投資戦略2017のサンドボックス制度活用への検討による技術競争力強化支援。
- ・トピックス調査結果の共有による技術競争力強化支援。
- ・計4回のプライベートセミナーの実施による技術競争力強化支援。
- ・プライベートセミナーでのワークショップ実施による会員交流・会員連携につながる場の提供。

(実績③)WINK2017と連携しオープンイノベーション創出の場を提供

- ・プライベートセミナーを活用し、受賞チームのアイデアのブラッシュアップ会の開催を予定。
- ・受賞チームのアイデアのビジネス化支援のために組込み開発企業展示会でのデモンストレーションを実施。

3.(企画広報事業)活動報告

2017年度 事業計画

1. “WINK”コンテストを軸としたオープンイノベーションの新たな仕組みづくり
 - －更なるサービス創出を見据えた産学官連携によるワークショップコンテストの実現
 - －第1部会、第2部会、企画・広報連動による協働型サービスインキュベーション施策の実現
2. 国立研究開発法人、大学、独立行政法人との連携による競争力強化のきっかけづくり
 - －研究機関との連携施策による注力分野の情報発信や共同研究のきっかけづくり
 - －セキュリティ、IoTなどの成長分野をテーマとした情報発信や研究会支援
3. 地域間連携及び団体間連携による更なる活動基盤の拡充
 - －第7回全国組込み産業フォーラムによる震災復興支援と団体間交流
4. 各部会施策の広報支援及びマルチメディアプロモーションによる機構のプレゼンス向上
 - －機構主要施策のプロモーション及びFACEBOOK・メルマガなど電子メディアを通じた情報発信
 - －関連団体イベントへの共催・後援・出展・講演などを通じた情報発信

2017年度の実績

(実績①) IoTをテーマにしたワークショップコンテスト「WINK2017」を実施(12/19)。

- ・産学による実行委員会のもと、産総研、慶應義塾大学、リンカーズ(初参加)等によるアイデアの洗練化及び池田泉州銀行によるサービス化に向けた資金面の協力体制を整え、7団体8チームがコンテストに参加。優勝、アイデア賞、技術賞を選定。
- ・第1部会施策である組込み適塾から2チームをコンテストに誘導、うち1チームがアイデア賞を受賞。サービス化に向けた第2部会のプライベートセミナーの活用は、まずは自社内での検討を優先して進めるという受賞チームの意向、組込み開発企業展示会での展示はサービスの具体化はこれからであるため、実現せず。
- ・サービスデザインの理論、事例、実践までをカバーする、オープンイノベーションセミナーを同時開催。参加者94名、好評価率90%。

(実績②) セキュリティ連携セミナーを開催(2/14)、またWINK2017における研究会活動を実施。

- ・IPA、KIIS、大阪商工会議所と共同でセキュリティ連携セミナーを開催。参加者136名。
- ・WINK2017の事前検討として、コンテスト参加4チームがコンテストまでの時限研究会として活動。産総研、慶應義塾大学等と連携しアイデアをブラッシュアップ。現在受賞企業内での検討に留まっているため、よりオープンな場としての研究会の継続性に課題。

(実績③) 震災復興支援を兼ねて、熊本(崇城大学)にて第7回全国組込み産業フォーラムを開催(2/2)。

- ・全国から組込み関連の9団体、産総研、経産省など、75名が参加。四国から高知県情報産業協会、関東からI・TOP横浜が初参加。
- ・地域連携セミナー(オープンイベント)を同日開催。農業、医療、交通×IoTをテーマに実施、参加者96名。

(実績④) 新聞記事掲載3件、外部イベントでの情報発信3件以上、共催・協賛・後援11件、ホームページ・メルマガ等でのプロモーション

- ・機構施策の広報活動により、新聞記事3件掲載(IoTへの取組み、組込み開発企業展示会、全国組込み産業フォーラム)。
- ・協賛・後援の外部イベントで組込み適塾の紹介等の情報を発信(セキュリティミニキャンブ、enPiTシンポジウム、ASIF2018等)。
- ・関連団体との連携強化と機構のプレゼンスの向上のため、8団体11イベントの共催・協賛・後援を実施。